

檔 號：
保存年限：

經濟部智慧財產局 審查意見通知函

機關地址：臺北市大安區辛亥路 2
段 185 號 3 樓

聯絡人：許培峰

聯絡電話：(02)23767342

電子郵件：

傳 真：(02)23779875

受文者：大陸商環旭電子股份有限公司（
代理人：張耀暉 專利師、莊志
強 專利代理人）

發文日期：中華民國 114 年 5 月 9 日

(114) 智專一（作）05299 字第

發文字號：11420490240 號 

速 別：速件 *11420490240*

密等及解密條件或保密期限：

附 件：如文

主旨：第113145016號專利申請案經審查有說明一所述情事，請
於文到次日起3個月內提出申復說明或修正。屆期未申復
說明或修正者，依專利法第46條第2項規定將不予專利，
請查照。

說明：

一、本案經審查認為：

(一)本案「餵料器、上料裝置及貼片系統」申請日為113年
11月22日，依申請人申請時所提摘要、說明書、申請專
利範圍及圖式進行審查，本案請求項共10項，其中請求
項1、7、9為獨立項，其餘為附屬項，合先敘明。

(二)本案請求項不符專利法第26條第2項之規定。

本案請求項6，所述之「所述傳動機構」，在所依附之
請求項及本項之技術內容中，並未見有該技術特徵之先
行詞，致使申請專利範圍不明確，不符專利法第26條第
2項之規定。

(三)本案圖式不符專利法第26條第4項之規定。

- 1、本案圖式第6圖依說明書所載為截面視圖，然其未參照工程製圖方法繪製清晰，不符專利法第26條第4項暨其施行細則第23條第1項之規定。
- 2、本案請求項7、9所記載之「…權利要求…」，應修正為「如請求項…」，請修正補充，併予指明。

(四)依據引證1揭示內容，本案請求項1~6不符專利法第22條第2項之規定；依據引證1~2揭示內容，本案請求項7~8不符專利法第22條第2項之規定；依據引證1~3揭示內容，本案請求項9~10不符專利法第22條第2項之規定。

- 1、本案請求項1，引證1之說明書第[0015]、[0026]~[0027]段及圖式第1~4圖已揭示：「一種餵料器，用於給貼片機供料，包括：本體，所述本體上形成有輸送通道【相當於引證1，物料通道18】，且所述本體位於所述輸送通道周圍設有傳送機構【相當於引證1，傳動機構4】，所述傳送機構用於帶動料帶【相當於引證1，SMT卷料6】沿所述輸送通道延伸方向移動；料帶上的元器件在所述傳送機構的傳送作用下被移送至取料位，供貼片機取料【相當於引證1，說明書第[0027]段真空軟管8需要和SMT捲料6一同塞入到物料通道18中，從物料通道18一直延伸到的取料槽口12的下方】；所述輸送通道上設有真空墊片【相當於引證1，真空軟管8】，所述真空墊片上開設有吸附孔【相當於引證1，真空吸孔15】和第一抽氣孔【相當於引證1，圖4出氣端軸14所指處】，及，建立所述吸附孔和元器件間的吸附通道【相當於引證1，說明書第[0024]段在取料槽口12正下方區域的真空軟



管8表面設計有一個真空吸孔15，在使用時透過把氣壓吹送到氣管連接的真空發生器7中，然後將輸出轉換成真空氣體，從而產生有吸力的作用，此孔就有真空吸附料帶元件的作用】；其中，至少位於所述真空墊片處的吸附通道被建立，所述第一抽氣孔被配置為抽取所述吸附孔和元器件之間的氣體，使所述真空墊片和元器件間形成真空，從而使至少位於所述真空墊片處的元器件被吸附【相當於引證1，說明書第[0026]段真空軟管8另一端的外表面設置為真空吸孔15，真空吸孔15的兩側均設置有限位卡箍16，且真空軟管8透過限位卡箍16與物料通道18連接，限位卡箍16的作用是對真空吸孔15區域的軟管進行限位】」之技術內容；引證1與本請求項之差異僅為「料帶上設有若干通孔，若干所述通孔可被選擇地與所述吸附孔相連通」之技術內容；然該技術僅係建立元器件可被吸附之結構【引證1說明書第[0015]段已揭示含有真空吸附料帶元件的作用】，該領域技術人自可依據作業及結構需求簡單變更；再查本項所請發明對照先前技術，並未產生無法預期之功效；故所請發明係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術能輕易完成者，不符專利法第22條第2項之規定。

- 2、本案請求項2，所附屬之技術內容為：「所述輸送通道上開設有定位孔，所述真空墊片背離所述吸附孔的一側設有定位銷，所述定位銷穿設於所述定位孔內以實現所述真空墊片和所述輸送通道的快速定位」之技術內容；查該技術僅係將真空單元固定之定位結構，該領域技術人員可依據作業及結構需求自行設定；再
- 

查本項所請發明對照先前技術，並未產生無法預期之功效；故所請發明係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術能輕易完成者，不符專利法第22條第2項之規定。

- 3、本案請求項3，引證1之說明書第[0024]段及圖式第1~2圖已揭示：「所述真空墊片位於所述輸送通道靠近所述取料位處，用於吸附靠近所述取料位的元器件【相當於引證1，說明書第[0024]段在取料槽口12正下方區域的真空軟管8表面設計有一個真空吸孔15，在使用時透過把氣壓吹送到氣管連接的真空發生器7中，然後將輸出轉換成真空氣體，從而產生有吸力的作用，此孔就有真空吸附料帶元件的作用】」之技術內容；故所請發明係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術能輕易完成者，不符專利法第22條第2項之規定。

- 4、本案請求項4，引證1之說明書第[0027]段及圖式第4圖已揭示：「所述真空墊片內設有通氣流道，所述通氣流道用於連通所述吸附孔和所述第一抽氣孔【相當於引證1，說明書第[0027]段取料槽口12正下方區域的真空軟管8表面設計有一個真空吸孔15，在使用時透過把氣壓吹送到氣管連接的真空發生器7中，然後將輸出轉換成真空氣體，從而產生有吸力的作用，及應含有通氣流道】，且所述第一抽氣孔設於所述真空墊片在所述輸送通道延伸方向上的一側，用於對接真空發生器【相當於引證1，真空發生器7】」之技術內容；故所請發明係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術能輕易完成者，不符專利法第22條

第2項之規定。

- 5、本案請求項5，所附屬之技術內容為：「所述輸送通道上方還設有壓料蓋，所述壓料蓋用於壓住所述輸送通道內的料帶；且所述壓料蓋靠近所述取料位的一端設有避讓孔」之技術內容；然查該技術僅係輸送料帶結構的簡單改變，該領域技術人員可依據作業及結構需求自行設定；再查本項所請發明對照先前技術，並未產生無法預期之功效；故所請發明係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術能輕易完成者，不符專利法第22條第2項之規定。
- 6、本案請求項6，引證1之說明書第[0024]段及圖式第1~2圖已揭示：「所述傳動機構包括齒輪【相當於引證1，貼片齒輪5】，所述齒輪上設有若干齒塊【相當於引證1，圖2已揭示貼片齒輪5含有齒塊】；所述本體位於所述輸送通道周圍設有用於容納所述齒輪的安裝空間【相當於引證1，圖1貼片齒輪5安裝之空間】，所述安裝空間具有開口，所述齒輪可轉動地固定於所述安裝空間內，且所述齒輪在轉動過程中，至少部分所述齒塊可被選擇地經所述開口伸出所述安裝空間；所述料帶上設有若干開孔，所述齒塊可被選擇地穿過所述開孔，以帶動所述料帶朝所述取料位方向移動【該技術僅係利用齒輪帶動料帶，引證1圖2已揭示含有貼片齒輪5，該領域技術人員自可依據作業需求調整料帶移動】」之技術內容；故所請發明係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術能輕易完成者，不符專利法第22條第2項之規定。
- 7、本案請求項7，引證1之說明書第[0027]段及圖式第



1~2圖已揭示：「一種上料裝置，包括：料盤【相當於引證1，卷料盤10】、真空發生器【相當於引證1，真空發生器7】和權利要求1-6任一項所述的餵料器【其引用主要技術內容與請求項1~6相同，僅為請求項1~6所述之餵料器，因此理由如上述1~6】；所述料盤上纏繞有所述料帶，所述料帶上的元器件在所述傳送機構的傳送作用下被移送至取料位，供貼片機取料【相當於引證1，說明書第[0027]段真空軟管8需要和SMT捲料6一同塞入到物料通道18中，從物料通道18一直延伸到的取料槽口12的下方】」之技術內容；引證1與本請求項之差異為引證1未揭示「所述真空發生器開設有相連通的供氣孔、第二抽氣孔和排氣孔，所述供氣孔用於對接外部氣源，所述第二抽氣孔用於對接所述第一抽氣孔，所述排氣孔用於排出所述真空發生器內氣體」之技術內容；查引證2說明書第[0034]、[0042]~[0043]段及圖式第1圖已揭示「所述真空發生器開設有相連通的供氣孔【相當於引證2，進氣口11】、第二抽氣孔【相當於引證2，真空口21】和排氣孔【相當於引證2，出氣口12】，所述供氣孔用於對接外部氣源【相當於引證2，說明書第[0034]段通氣管1上進氣口11的一端通常與能夠產生高壓氣體的設備連通】，所述第二抽氣孔用於對接所述第一抽氣孔【相當於引證2，說明書第[0042]段真空口21也為本裝置的吸附端，該領域技術人可依據作業需求自行設定對接所需真空之位置】，所述排氣孔用於排出所述真空發生器內氣體【相當於引證2，說明書第[0043]段當需要使得真空管2處於真空狀態時，向通





氣管1的進氣口11通高壓氣體，然後高壓氣體從通氣管1的出氣口12流向下一個設備】」之技術內容；由於引證1~2均屬於「使用壓縮氣源產生負壓」的相關技術領域，又皆在「設定真空發生器進氣或出氣管路」之功能或作用具有共通性，綜上考量，該發明所屬技術領域中具有通常知識者自當有明顯結合引證1~2技術內容之動機完成本請求項之發明；故所請發明係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術能輕易完成者，不符專利法第22條第2項之規定。

- 
- 8、本案請求項8，引證2之說明書第[0034]、[0042]段及圖式第1圖已揭示：「所述真空發生器在所述排氣孔處設置了消音器【相當於引證2，說明書第[0022]段所述通氣管和所述連接管的管壁內均設置有消音件】；所述供氣孔通過第一氣管連接外部氣源【相當於引證2，說明書第[0034]段通氣管1上進氣口11的一端通常與能夠產生高壓氣體的設備連通】，所述第二抽氣孔通過第二氣管連接所述第一抽氣孔【相當於引證2，說明書第[0042]段真空口21也為本裝置的吸附端，該領域技術人可依據作業需求自行設定對接所需真空之位置】」之技術內容；故所請發明係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術能輕易完成者，不符專利法第22條第2項之規定。
- 9、本案請求項9，引證3之說明書第[0035]段及圖式第1~4圖已揭示：「一種貼片系統，包括：貼片機和權利要求7-8任一項所述的上料裝置；所述貼片機包括貼片機主體【相當於引證3，貼合裝置100】和貼裝頭



【相當於引證3，吸取件73】，所述貼裝頭在所述貼片機主體和所述上料裝置間往返移動，以將所述上料裝置輸送的料帶上的元器件運送至所述貼片機主體內進行貼裝【相當於引證3，說明書第[0035]段移動軸71於控制器20之控制下帶動吸取件73移動至取料孔5535之上方。吸取件73吸取貼附件200從送料帶35上剝取下來，且貼附至電子產品配件300上之黏膠層301，使得貼附件200貼合於黏膠層301上】」之技術內容；由於引證1~3皆在「利用壓縮氣體吸附元件」之功能或作用具有共通性，綜上考量，該發明所屬技術領域中具有通常知識者自當有明顯結合引證1~3技術內容之動機完成本請求項之發明；故所請發明係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術能輕易完成者，不符專利法第22條第2項之規定。

- 
- 10、本案請求項10，引證3之說明書第[0035]段及圖式第1~4圖已揭示：「所述貼裝頭設有吸嘴【相當於引證3，吸取件73】，用於吸附料帶上的元器件【相當於引證3，說明書第[0035]段吸取件73吸取貼附件200從送料帶35上剝取下來】；所述吸嘴的吸附力大於所述真空墊片上所述吸附孔的吸附力【該技術僅係設定吸嘴吸附力，引證3說明書第[0035]段已揭示吸取件73吸取貼附件200從送料帶35上剝取下來，且貼附至電子產品配件300上之黏膠層301，該領域技術人員可依據作業需求自行設定吸附力】」之技術內容；故所請發明係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術能輕易完成者，不符專利法第22條第2項之規定。

(五)引證文件：

- 1、CN217217331U
- 2、CN117432608A
- 3、TW201512064A

- 二、本案如有修正、訂正，應依專利法第43條、第44條第3項、專利法施行細則第36條至第38條之規定辦理，並請依專利修正申請書、專利誤譯訂正申請書之規定撰寫。
- 三、若需當面示範或說明者，請以「面詢申請書」敘明面詢所依據之版本、面詢事項及說明並繳交規費新台幣1千元，本局認為有必要時，將另行通知面詢地點及時間。
- 四、檢送本案檢索報告1份。本案檢索報告如附有引證用之非專利文獻，僅供專利申請人個人參考之用，如涉及其他利用該著作之行為(如：列印紙本對公眾散布、將檔案上傳網路等)，仍應取得著作財產權人之同意或授權，以避免侵權。

正本：大陸商環旭電子股份有限公司（代理人：張耀暉 專利師、莊志強 專利代理人）

副本：